

TOPPAN、次世代半導体パッケージのコンソーシアム「US-JOINT」に参画

米国シリコンバレーで日米の材料・装置メーカーと連携し、
先端半導体パッケージにおけるベストソリューションを提供

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、大手半導体後工程材料メーカーである株式会社レゾナック(本社:東京都港区、代表取締役社長 高橋 秀仁、以下 レゾナック)が主導し 2024 年 7 月に設立された次世代半導体パッケージ分野の日米混合のコンソーシアム「US-JOINT(読み:ユーエスジョイント)」(※1)に、2024 年 11 月 18 日より、パッケージ基板メーカーとして参画しました。

今後、TOPPAN は、「US-JOINT」が進める、米国における次世代半導体パッケージの評価プラットフォームの創成と実装技術の開発に参画し、次世代半導体パッケージング技術の進化に貢献します。



■ 背景と狙い

急速に需要が拡大している生成 AI や自動運転向けなどの次世代半導体では、2.5D、3D(※2)パッケージなど、半導体パッケージの構造の複雑化に伴い、使用される材料の種類も増加しています。近年では、米国を中心に、大手ファブレス半導体メーカーや大手テック企業が、自社で半導体の設計・開発を進める動きが活発化しており、顧客のすぐ近くで、スピーディーかつ緊密な共創・すり合わせができる体制が求められています。

レゾナックが主導する「US-JOINT」は、米国シリコンバレーを拠点とし、日米の有力な材料・装置等のメーカー10社が参画する、半導体パッケージング技術開発の共創プラットフォームです。

TOPPAN は今般「US-JOINT」に参画することで、TOPPAN の強みであるハイエンドのパッケージ基板の技術開発力を活かし、顧客の関心の高い先端半導体パッケージング技術の課題解決に貢献し、新たなビジネスの機会創出につなげるとともに、半導体パッケージ基板事業の強化を目指します。

■ 今後の展開

「US-JOINT」は、活動拠点を米国シリコンバレーに置き、2025年の稼働開始を目標に、2024年からクリーンルームや装置導入等の準備を開始します。試作ラインでは、チップ実装、インターポーザー、パッケージ基板など、最先端の後工程の研究開発が行われます。TOPPAN は、「US-JOINT」のメンバーの一員として、FC-BGA 基板や次世代半導体パッケージ部材を提供し、顧客のニーズをリアルタイムにキャッチし、後工程材料やプロセス技術の研究開発を加速します。

※1 US-JOINT プレスリリース URL:<https://www.resonac.com/jp/news/2024/07/08/3118.html>

※2 2.5D は複数のチップをインターポーザーと呼ばれるシリコン基板上に実装する技術。3D は複数のチップを積層する技術。

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上